

無機・有機複合材料で放熱問題に挑む ～ 物理と応用の最前線 ～

2018年3月19日(月) 13時15分～ 18時50分

早稲田大学西早稲田キャンパス 52号館 C304

光・電子デバイスの高性能化・小型化が進み、放熱および冷却が喫緊の課題になっており、デバイス全体の熱設計の重要性が増しています。課題解決のためには、無機と有機各材料中の熱伝導はもちろん、界面や複合系における熱伝導現象の理解が重要です。本シンポジウムでは、「フォノン」をキーワードに基礎から応用までをカバーし、両コミュニティおよび放熱問題に関心のある方々との交流を図ります。

- 13:15 野村政宏 東京大学生産技術研究所
オープニング
- 13:25 塩見淳一郎 東京大学
無機・有機複合材料の界面熱輸送の評価と制御
- 14:10 宮崎康次 九州工業大学
無機・有機複合材料の低熱伝導率を利用した熱電特性向上
- 15:10 小原拓 東北大学
ポリマー液体・ソフトマター中の熱輸送と固体接合界面熱抵抗低減
- 15:55 森川淳子 東京工業大学
高放熱性コンポジットの熱物性測定
- 16:40 中村雅一 奈良先端科学技術大学院大学
分子接合によるカーボンナノチューブ凝集体の熱伝導率制御の可能性
- 17:10 竹澤由高 日立化成
高分子材料の熱伝導と高熱伝導化技術
- 17:55 熊本拓朗 日本ゼオン
スーパーグロス・カーボンナノチューブ含有の熱界面材料と応用
- 18:40 丸山茂夫 東京大学
クロージング

企画

合同セッションM「フォノンエンジニアリング」
フォノンエンジニアリング研究グループ
機能材料・萌芽的デバイス(12.3)

世話人

野村 政宏(東大生研)
山本 貴博(理科大)
馬場 寿夫(JST)
野々口斐之(奈良先端大)